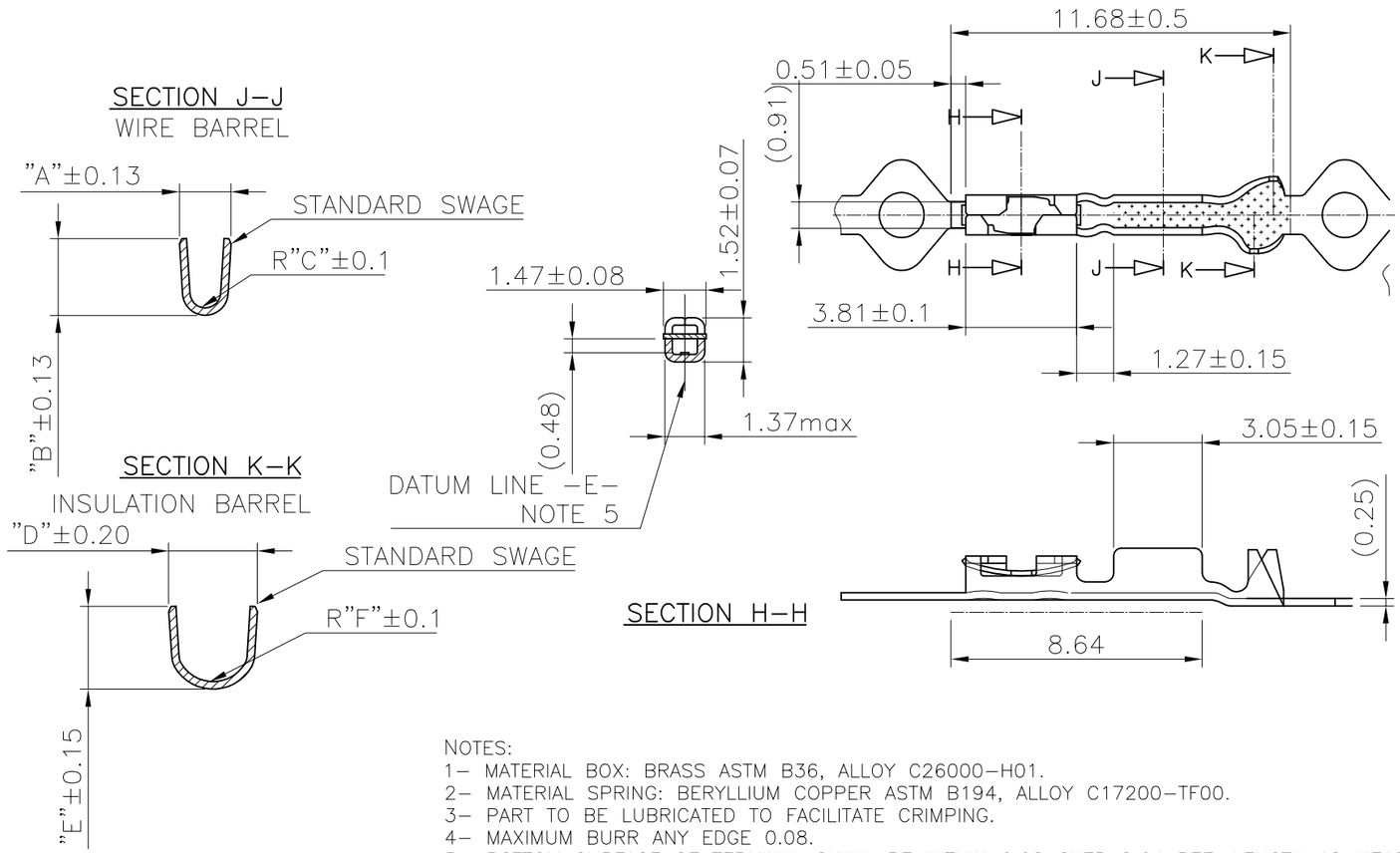
PRODUCT NO.	PLATING CODE	AWG RANGE	SPRING THICKNESS
75231–032LF	A	22–26	0.17
75231–031LF	A	22–26	0.09
75231–030LF	A	22–26	0.12
75231–029LF	A	28–32	0.17
75231–028LF	A	28–32	0.12
75231–027LF	B	22–26	0.17
75231–026LF	B	22–26	0.09
75231–025LF	B	22–26	0.12
75231–024LF	B	28–32	0.17
75231–023LF	B	28–32	0.12
75231–015LF	C	22–26	0.17
75231–014LF	C	22–26	0.09
75231–013LF	C	22–26	0.12
75231–004LF	C	28–32	0.17
75231–003LF	C	28–32	0.09
75231–002LF	C	28–32	0.12

75231–XXXLF IS SIMILAR TO 75231–XXX, THE SUFFIX 'LF' IS ADDED FOR LEAD FREE IDENTIFICATION.

AWG RANGE	WIRE BARREL A	B	C	INSULATION BRL. D	E	F	INSULATION RANGE
22–26	1.78	1.78	0.43	1.70	1.93	0.56	0.51–1.14
28–32	1.37	1.47	0.28	1.70	1.93	0.56	0.51–1.14

PLATING CODE	PLATING THICKNESS CONTACT AREA	INSIDE BOX	REMAINDER	UNDER LAYER
A	0.76µm Au	0.2µm Au	GOLD FLASH	1.3µm Ni
B	1.0µm Au	0.2µm Au	GOLD FLASH	1.3µm Ni
C	1.0µm Au	0.2µm Au	0.2µm Au	1.3µm Ni



NOTES:
1– MATERIAL BOX: BRASS ASTM B36, ALLOY C26000–H01.
2– MATERIAL SPRING: BERYLLIUM COPPER ASTM B194, ALLOY C17200–TF00.
3– PART TO BE LUBRICATED TO FACILITATE CRIMPING.
4– MAXIMUM BURR ANY EDGE 0.08.
5– BOTTOM SURFACE OF TERMINAL SHALL BE WITHIN 0.08 OVER 8.64 REF. LENGTH AS MEASURED ALONG DATUM LINE –E– ESTABLISHED AT C OF 1.37 DIMENSION PERFECT FORM NOT REQUIRED AT MMC.
6– TAB CUT–OFF DIMENSION IS VERY CRITICAL WHEN USED IN CONJUNCTION WITH MINI–ROD AND MINI–LATCH HOUSING.
7– PART TO MATE WITH 0.64±0.05 SQUARE PIN.
8– APPLICATION SPECIFICATIONS:
  a BUS–20–025 PRODUCT SPECIFICATION.
9– RoHS COMPATIBLE PRODUCT SPECIFICATIONS
  a– PLATING:
    – "LF" MEANS THE PRODUCT IS LEAD–FREE,
  b– LABELING:
    MEETS PACKAGING SPECS AS PER GS–14–920
  c– LEGAL STATEMENT: SEE GS–22–008
THE PRODUCT IS NOT INTENDED TO BE EXPOSED TO A MANUFACTURING SOLDER PROCESS.

ltr	ecn no	dr	date
B	B	HHC	83.08.31
C	F05–0235	DLE	05.09.13
D	F05–0286	DLE	05.11.07
E	F06–0217	DLE	06.07.11
F	F06–0276	DLE	06.09.14
G	F08–0160	PNZ	08.04.21

mat'l. code: SEE DRAWING
surface: ISO 1302
tolerance: ISO 406 ISO 101
tolerances unless otherwise specified: angles ±2°; linear ±13
projection: mm
scale 10:1

dr	D LEGRAND	05.08.30
engr	P NIZZI	05.08.30
chr	COMPAGNON	05.08.30
appd	P NZ	05.08.30

product family: BERGCON
title: CTW MINI PV SMALL INSULATION
dwg no: 75231
sheet 1 of 1
size: A3
type: CUSTOMER Drawing

sheet index | revision | sheet

FCIconnect.com
Copyright FCI

form: A3
R:\...\Engineering\Product\ELX\F08-0160\75231c01.dwg

PDM: Rev:G STATUS:Released Printed: Jun 06, 2009

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9